



ЭТИКЕТКА

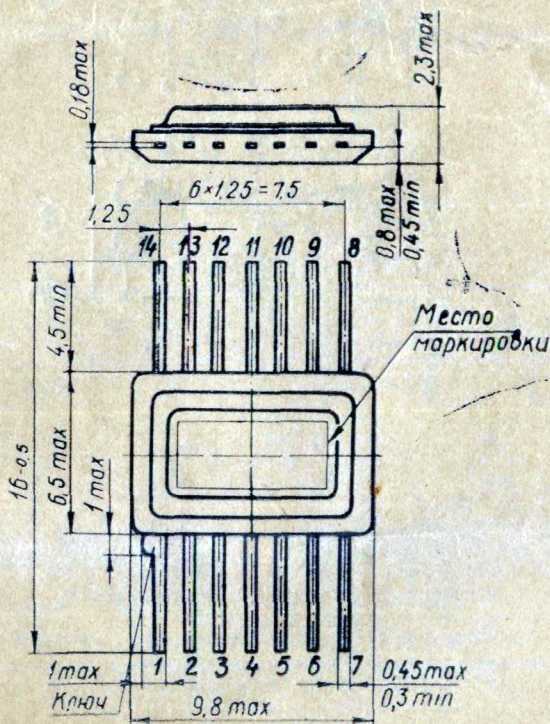
НА МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТИПА
ОС106ЛБ2, ОС106ЛБ2А

3.402.010 СЧТУ

Партия №

3059

1. Основное назначение: выполнение логической операции «И—НЕ/ИЛИ—НЕ».
2. Габариты.



Предельные отклонения размеров между осями двух любых выводов $\pm 0,1$ мм.

Цифры 1, 2, 3, 4 14 — номера выводов, показаны условно.

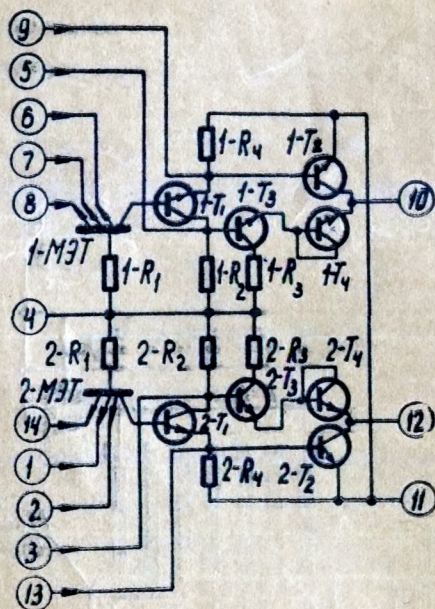
Ключ определяет нумерацию выводов.

Форма ключа не регламентируется.

Дно неметаллическое.

Допускаются напыльы стеклокерамики по выводам за пределы наружного контура корпуса микросхемы не более 0,5 мм на сторону.

8. Электрическая схема.



Номера выводов входов «И»: 6-7-8-14-1-2.

4. Масса микросхемы не более 0,35 г.

5. В одной микросхеме содержится 0,0147864 г золота, 0,0011052 г серебра.

6. Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 10^\circ\text{C}$:

а) выходное напряжение логического «0» не более 0,25В;

б) выходное напряжение логической «1» не менее 2,3В;

в) входной ток логического «0» $I_{\text{вх}}^0 \leq 0,6\text{мА}$;

г) входной ток логической «1» $I_{\text{вх}}^1 \leq 60\text{мкА}$ при $U_{\text{вх}} = 4,5\text{В}$.

д) время задержки распространения информации:

$t_{\text{оз.р.}}^{10} \leq 100\text{нс}$ для ОС106ЛБ2; $t_{\text{оз.р.}}^{10} \leq 35\text{нс}$ для ОС106ЛБ2А;

$t_{\text{оз.р.}}^{01} \leq 100\text{нс}$ для ОС106ЛБ2; $t_{\text{оз.р.}}^{01} \leq 50\text{нс}$ для ОС106ЛБ2А;

7. Эксплуатационные данные:

а) напряжение питания $E = 5\text{В} \pm 10\%$;

б) предельно допустимая мощность, рассеиваемая на корпусе:

$P_{\text{пр}} \leq 100\text{мВт}$. (от $-60^\circ \div +100^\circ\text{C}$);

$P_{\text{пр}} \leq 55\text{мВт}$. (свыше 100°C);

в) максимальная частота переключения:

$F = 1\text{МГц}$ для ОС106ЛБ2 при $P_{\text{пр}} \leq 100\text{мВт}$;

$F = 3\text{МГц}$ для ОС106ЛБ2А при $P_{\text{пр}} \leq 100\text{мВт}$;

г) максимальная средняя потребляемая статическая мощность — $7 \times 2\text{мВт}$;

— нагрузочная способность $N = 10$;

— диапазон рабочих температур от минус 60°C до $+125^\circ\text{C}$.

8. Время минимальной наработки 15000 час.

9. Срок хранения — 15 лет.

10. Указания по эксплуатации:

а) микросхемы, выпускаемые по 3.402.010 СЧТУ, должны применяться и эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями 3.402.010 СЧТУ, разделом 5.0СТ В11.073.012-74 и руководством по применению 0СТ11 БК0.340.010-74, выпускаемым головным предприятием по применению микросхем по запросам предприятий-потребителей;

б) при наработке микросхем в течение 30000 час. должны обеспечиваться условия эксплуатации при $t = 25 \pm 10^\circ\text{C}$ и снижение электрических, климатических и механических нагрузок относительно номинальной не менее чем на 30%.

в) при работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуру должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов с величиной потенциала более 80В. Для устранения электростатических зарядов на микросхемы необходимо иметь инструкцию, предусматривающую меры по уменьшению аккумуляции электрических зарядов, согласованную с головным предприятием по применению микросхем;

г) при формовке выводов величина растягивающего усилия, направленного вдоль оси вывода, не должна превышать 0,12 кгс. Разрешается только однократная формовка выводов;

д) разрешается только одноразовая пайка микросхем на плату. Допускается двухразовая пайка не более 5 выводов микросхемы;

е) корпуса микросхем должны устанавливаться на печатную плату вплотную по всей поверхности корпуса с помощью клея, выводы закреплять методом расплавления. При приклейке должно соблюдаться равномерное воздействующее усилие прижатия корпуса не более 0,5 кгс. Не допускается воздействие крутящих и изгибающих моментов;

ж) запрещается кручение выводов микросхем вокруг оси и изгиб выводов в плоскости корпусов микросхем;

з) при работе микросхем в аппаратуре неиспользуемые входы одной ячейки (МэТа) рекомендуется объединять с одним из используемых входов или подключать к источнику питания микросхем через резистор величиной $1\text{ кОм} \pm 10\%$, при этом к одному резистору можно подключать до 20 свободных входов.

Примечания:

1. При объединении неиспользуемых входов с одним из используемых следует учитывать, что нагрузочная способность микросхем по уровню логической единицы определяется числом подключаемых входов.
2. Неиспользуемые входы разрешается также подключать к выходам неиспользуемых вентилях, при этом входы последних следует подключать к уровню логического «нуля» или заземлять.
3. В технически обоснованных случаях по согласованию с п/я А-7538 допускаются другие решения по использованию незадействованных выводов.

и) микросхемы в блоках аппаратуры рекомендуется покрыть лаком (например УР-231 или ЭП-730), обеспечивающим лучшую работоспособность микросхем в условиях повышенной влажности, морского тумана, инея и росы. Количество слоев при покрытии лаком — не менее 3;

к) способ установки микросхем на платы и демонтаж микросхем должен обеспечивать отсутствие усилий, деформирующих корпус (или приводящих к деформации корпуса).

Штамп ОТК.

ОТК 6

Штамп П.З.



1 3 ИЮН 1977

771254